

应用介绍

特点

一款单组份环氧树脂导电胶，加热固化；使用于多种材料之间的粘接，耐高温低CTE等特点，尤其适用于电子元器件导通及热敏感器件粘接，具有优异的导电性及可靠性性能，

粘接材料
典型应用

金属，陶瓷，塑料/PCB，玻璃等
芯片及敏感器件粘接固定

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	银色	
粘度(cps)	26000	5rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	60mins@150°C	
比重	3.5g/cm ³	
有效期@ -5°C,月	6	

*固化温度是指达到胶水表面的实际温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	银色	
邵氏硬度	73D	ASTM D-2240
玻璃化温度Tg	103°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
导电率	7×10 ⁻⁴ ohm*cm	IEC 60167:1964,IDT
降解温度	360°C	

可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	
工作温度范围	-55°C—150°C	

储存和使用方法

产品需低于-5°C环境中保存，使用前请先移至室温解冻，10ml 包装至少回温 1 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考SDS 文件；

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

研发期间产品参数不作为最终参数，仅供参考。

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

